



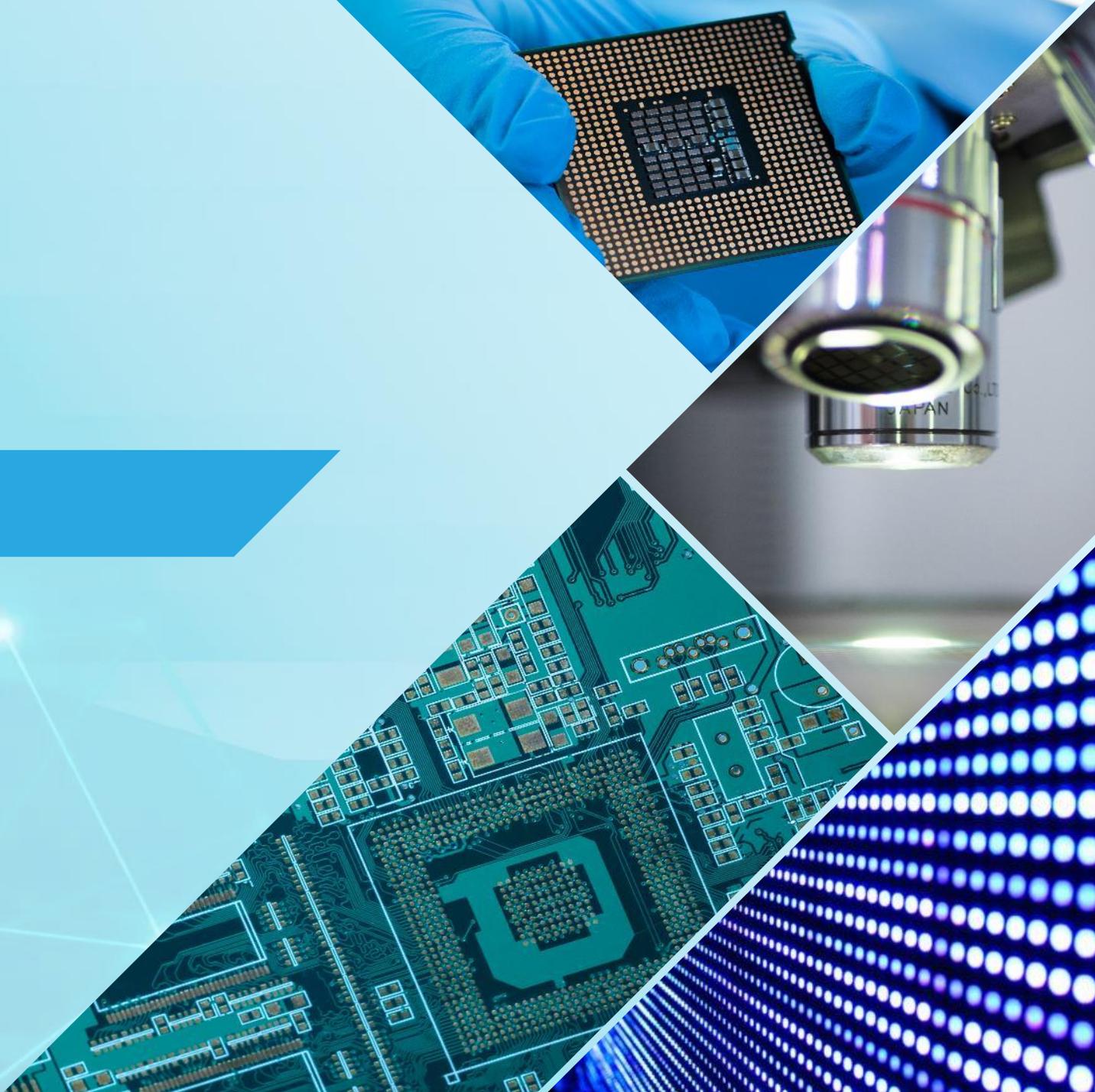
晶彩科技股份有限公司
FAVITE Inc.



自動化光學檢量測設備
專業領導廠商

2023年法人說明會

股票代號：3535



晶彩科技對於現狀期待與預測陳述屬前瞻性陳述，實際結果可能因已知或未知之風險、不確定性及其他之因素，而與前瞻性陳述所包含或暗示的內容有明顯出入。

此前瞻性陳述並非晶彩科技對未來履行之保證，故您不應依賴此前瞻性陳述。除法律有所要求，否則晶彩科技不負責更新、更正任何前瞻性陳述，不論日後是否有發生新資訊、事件等。



01 | 公司簡介

02 | 市場概況

03 | 營運重點

04 | 財務報告

05 | Q&A



目
錄

CONTENTS

01 | 公司簡介

02 | 市場概況

03 | 營運重點

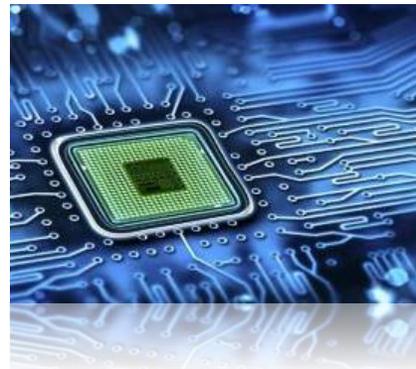
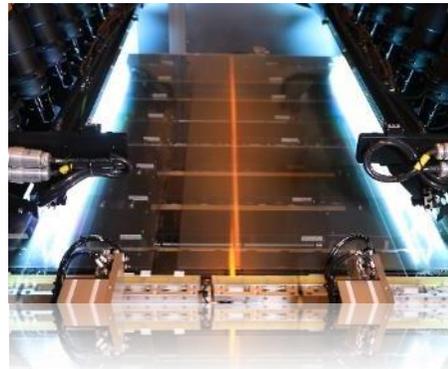
04 | 財務報告

05 | Q&A

公司簡介

- ✍ 設立登記：2000年
- 📈 公開上市：2008年
(3535)
- 👤 員工人數：260人
- 📍 公司總部：台灣新竹
- 🔧 營業項目：自動光學檢測/量測設備
- 🌐 官方網站：<https://www.favite.com/>

AI AOI領導品牌



企業沿革

- 2022年**
推出FOWLP Die Location量測機，獲知名封測大廠採用。
- 2021年**
推出首台AI AOI並與知名PCB及Micro LED先驅大廠合作導入。
- 2020年**
Mini LED/Micro LED新技術應用，發表mm LED 檢查機，獲得知名廠商成功導入。
- 2019年**
獲經濟部科專計畫，開發應用於FOPLP的2um RDL超細微線路AOI。
- 2017年**
跨足半導體產業，發表自動Glass Wafer檢查機，並獲大廠採用。
- 2010年**
進軍中國市場，成為大中華區(G4.5-G10.5)主要AOI供應商。
- 2005年**
發表TFT-LCD Array AOI，陸續獲得各面板大廠導入使用。
- 2000年**
自工研院育成中心正式成立。



目錄

CONTENTS

01 | 公司簡介

02 | 市場概況

03 | 營運重點

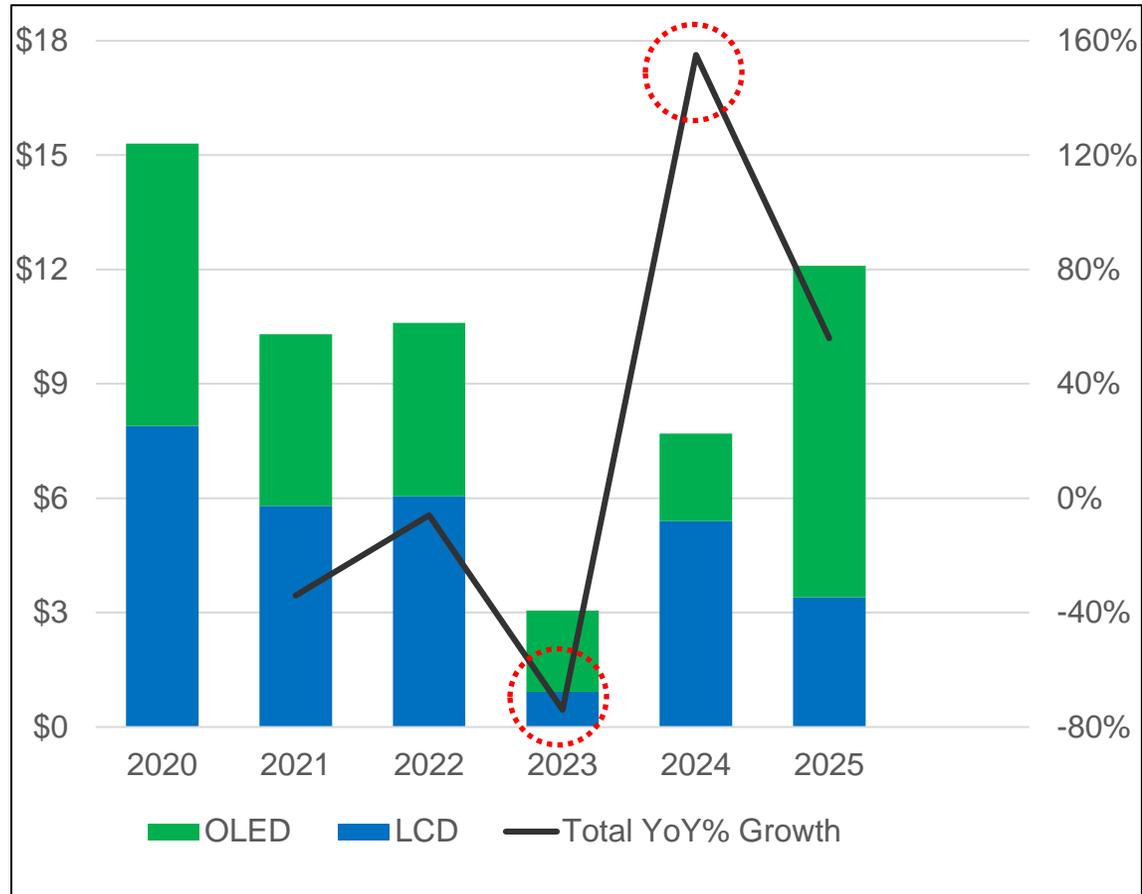
04 | 財務報告

05 | Q&A

市場概況與營運重點 - FPD

單位：十億美元

單位：YoY增長率



Source : Omdia; Data Summarized and Predicted by FAVITE.

FPD市場機會



舊設備升級



中國大陸
建廠擴廠



市場概況與營運重點 – Micro LED



家用/商用
大型顯示



智慧穿戴



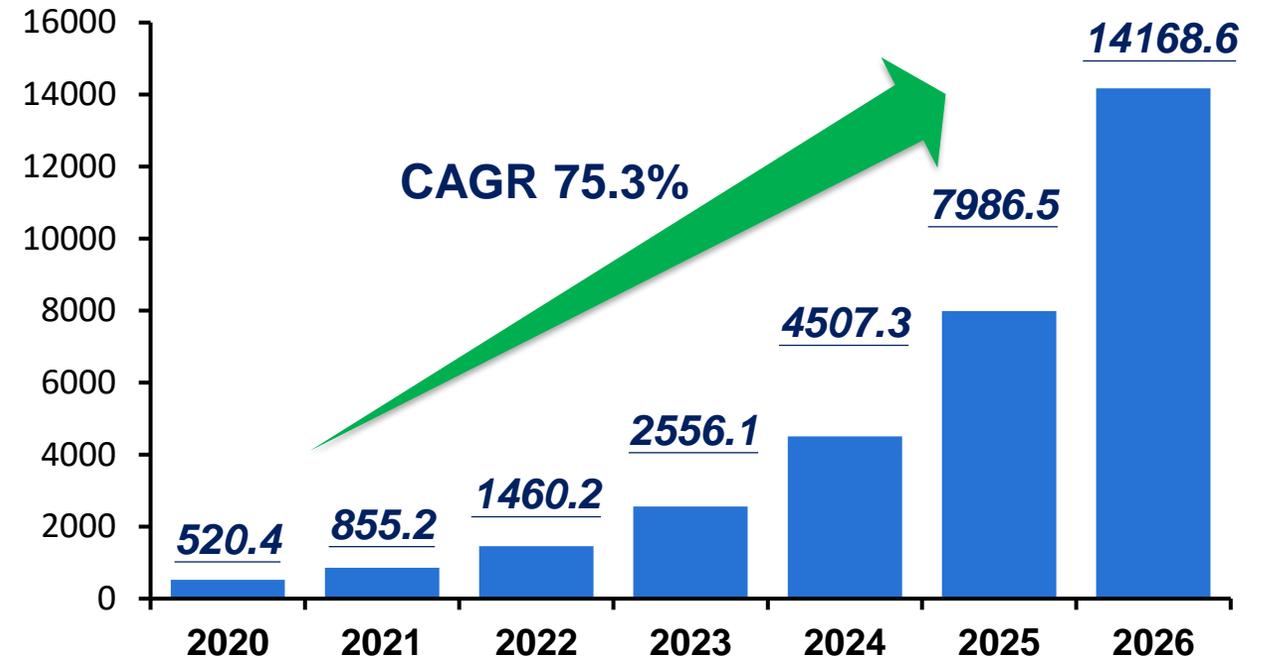
AR/VR 應用



車載顯示

Micro LED 市場規模, 2020-2026

單位：百萬美元



Source : Stratview Research; data summarized and predicted by FAVITE

市場概況與營運重點 – Micro LED

晶彩科技所推出的**Micro LED** 全系列檢量測解決方案
已打入台灣及中國大陸重點客戶，營收占比逐步提升

Chip On Wafer/Carrier AOI



Panel Pad & Chip AOI



Panel Side Wiring AOI



Backplane AOI



LED Chip
On Wafer

Mass
Transfer

LED Chip
On Carrier

Mass
Transfer

Micro LED
Panel

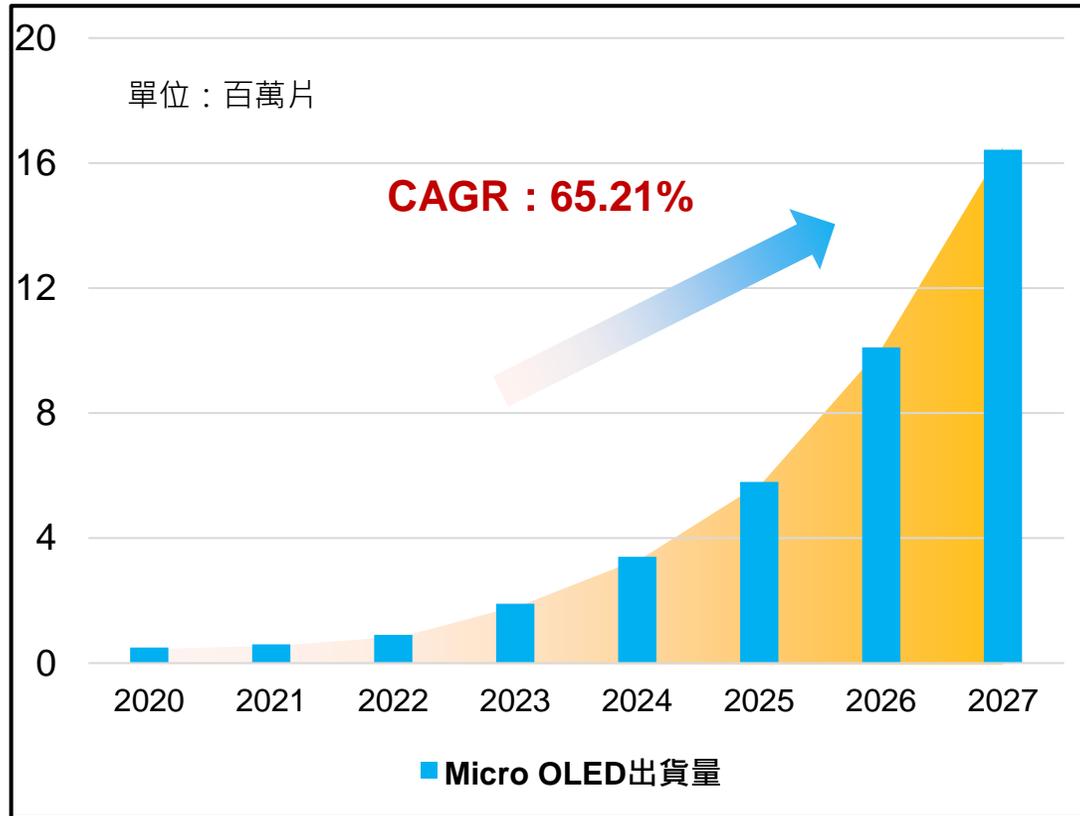
Bonding

TFT/PCB
Panel

Cutting

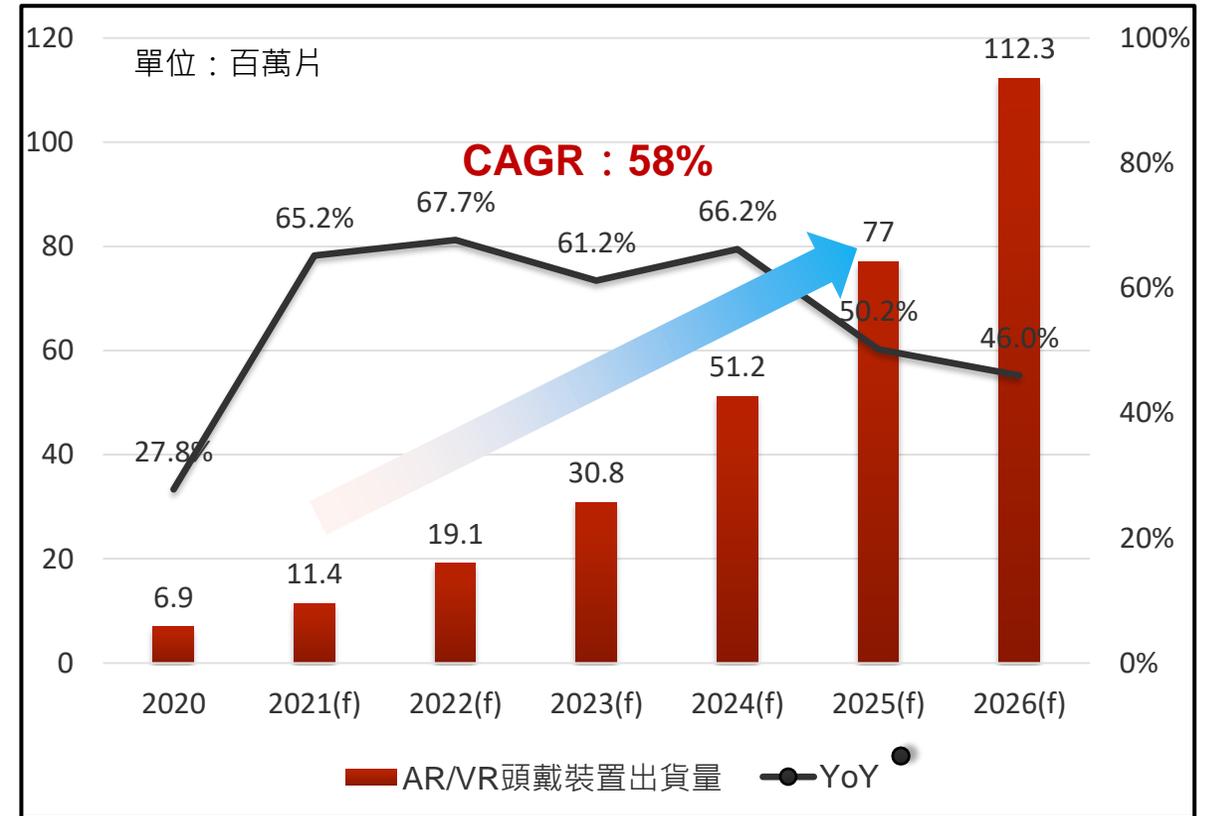
TFT/PCB
Backplane

2021-2027年全球Micro OLED出貨預測



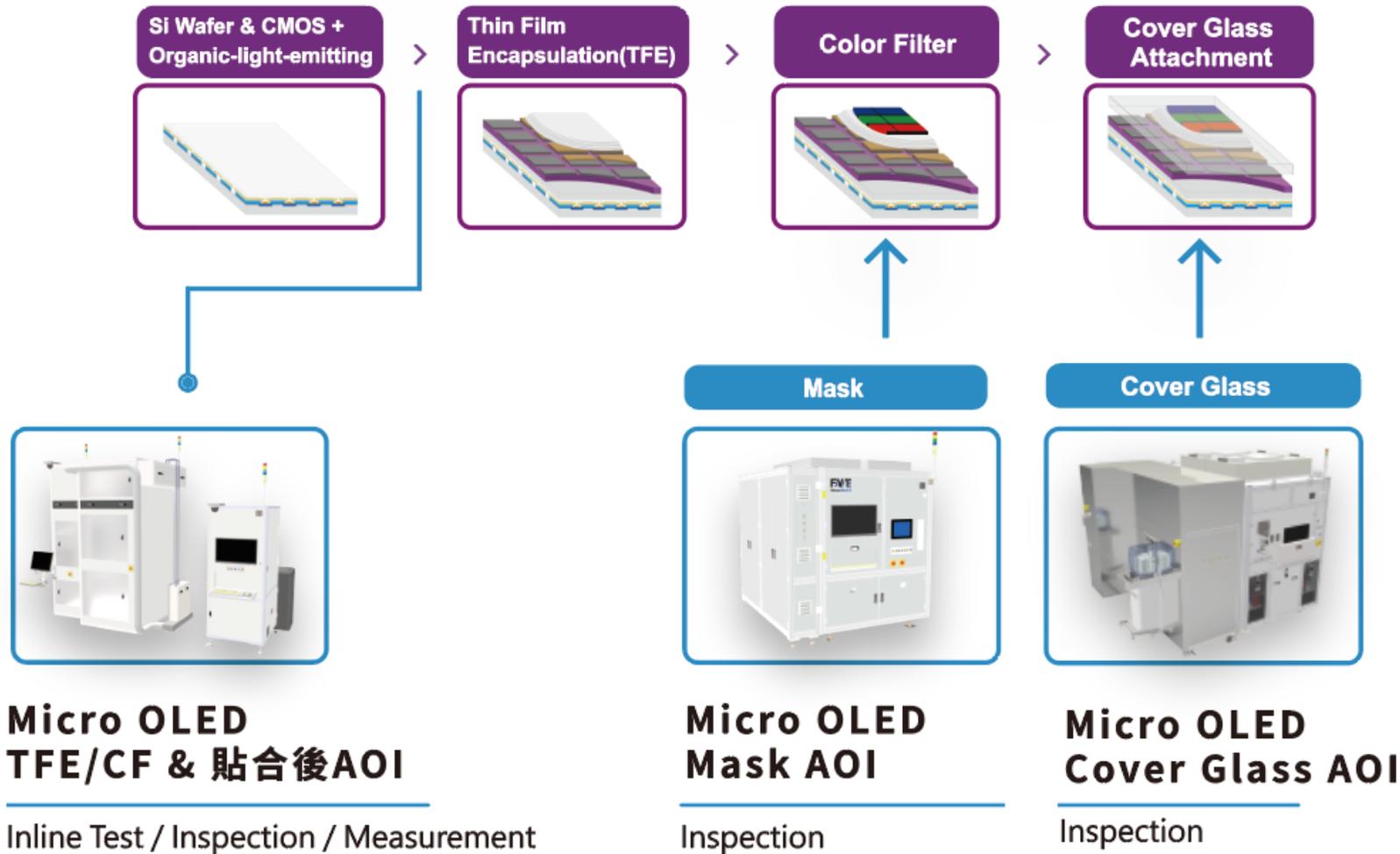
Source : DIGITIME Research; Data Summarized and Predicted by FAVITE.

2021-2026年全球AR/VR頭戴裝置出貨量



Source : DIGITIME Research; Data Summarized and Predicted by FAVITE.

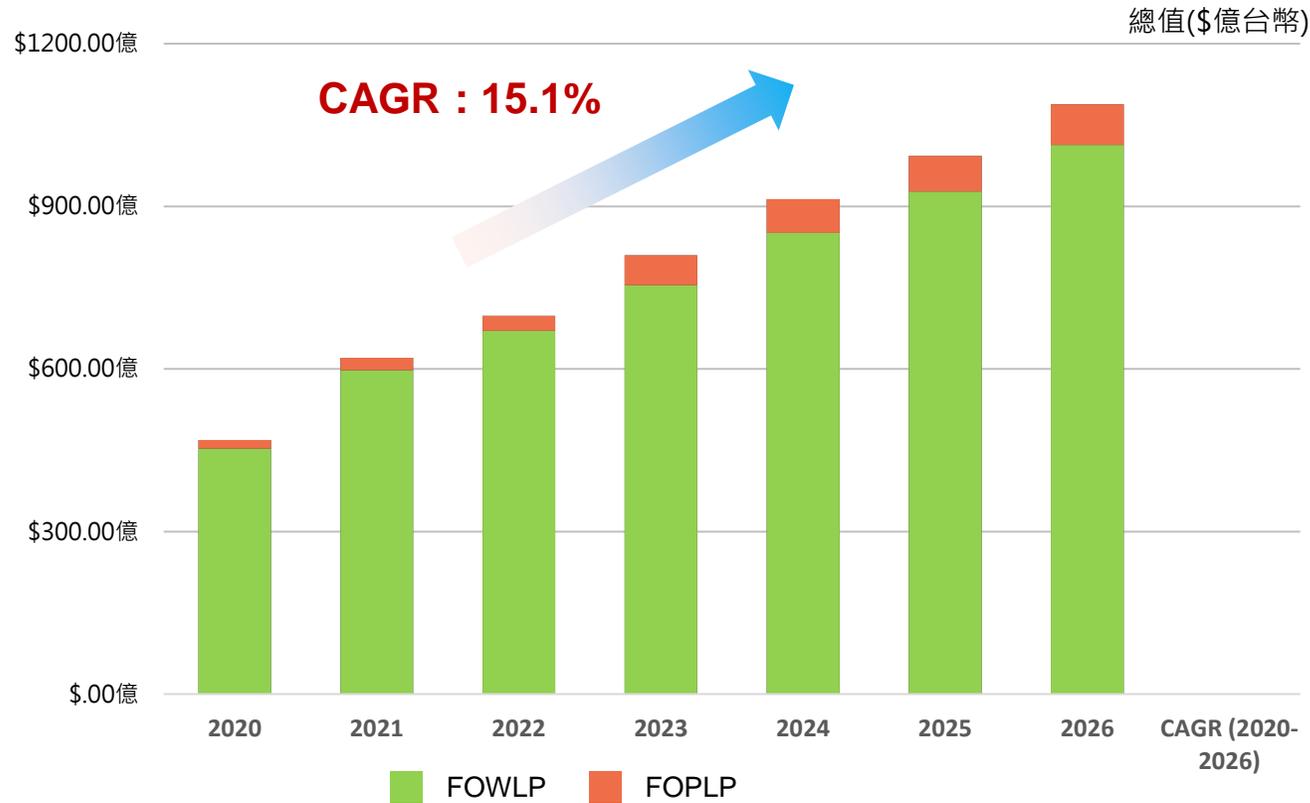
市場概況與營運重點 – Micro OLED



晶彩科技所推出的Micro OLED
全系列檢量測解決方案，已成功
打入中國大陸重點客戶，展望未
來能逐步放量。

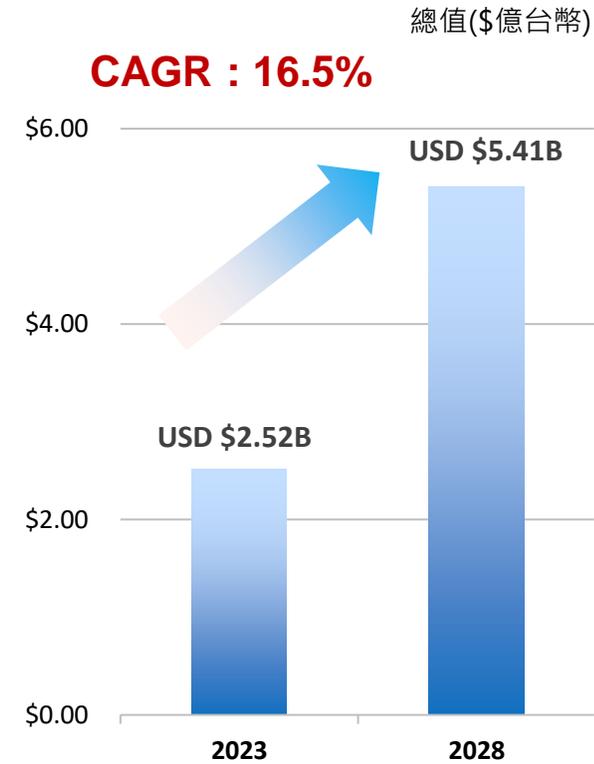
市場概況與營運重點 – 先進封裝(FOWLP/FOPLP)

2020-2026年全球Fan-Out市場總值

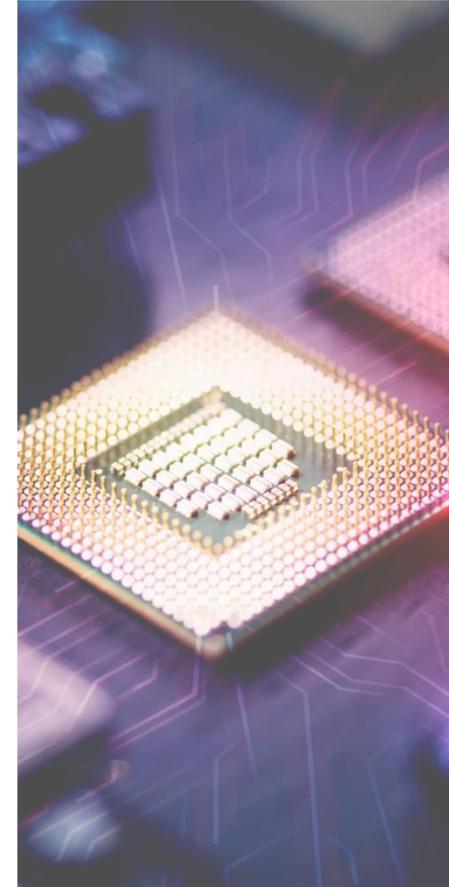


Source : Yole Development; Data Summarized and Predicted by FAVITE.

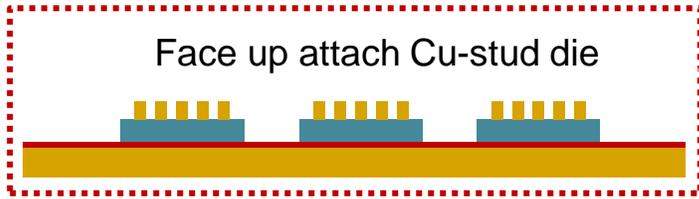
2023-2028 Fan-Out封裝市場規模



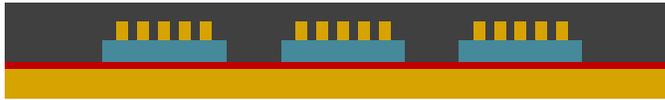
Source : Mordor Intelligence; Data Summarized and Predicted by FAVITE.



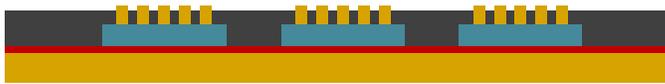
市場概況與營運重點 – 先進封裝(FOWLP/FOPLP)



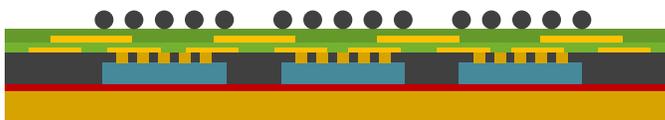
Molding



Expose Cu studs



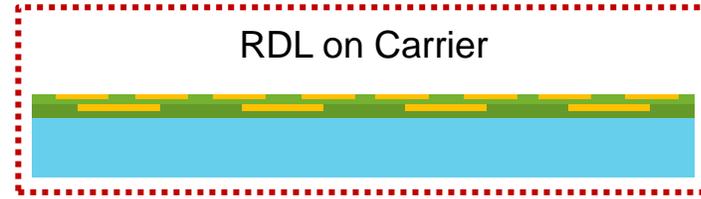
RDL and solder ball/bump attach



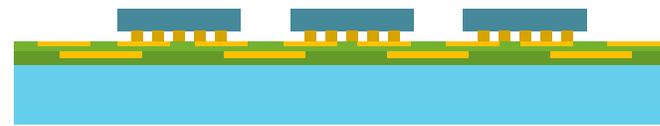
Carrier removal



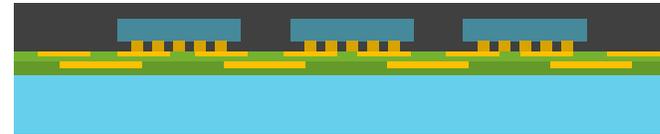
FOWLP/FOPLP
Die Location量測機



Face-down attach & Reflow



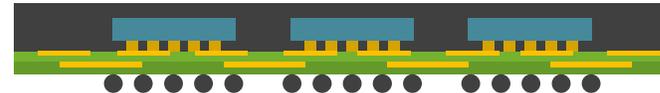
Molding



Carrier removal



Solder ball/bump attach



FOPLP Fine line RDL AOI



目錄

CONTENTS

01 | 公司簡介

02 | 市場概況

03 | 營運重點

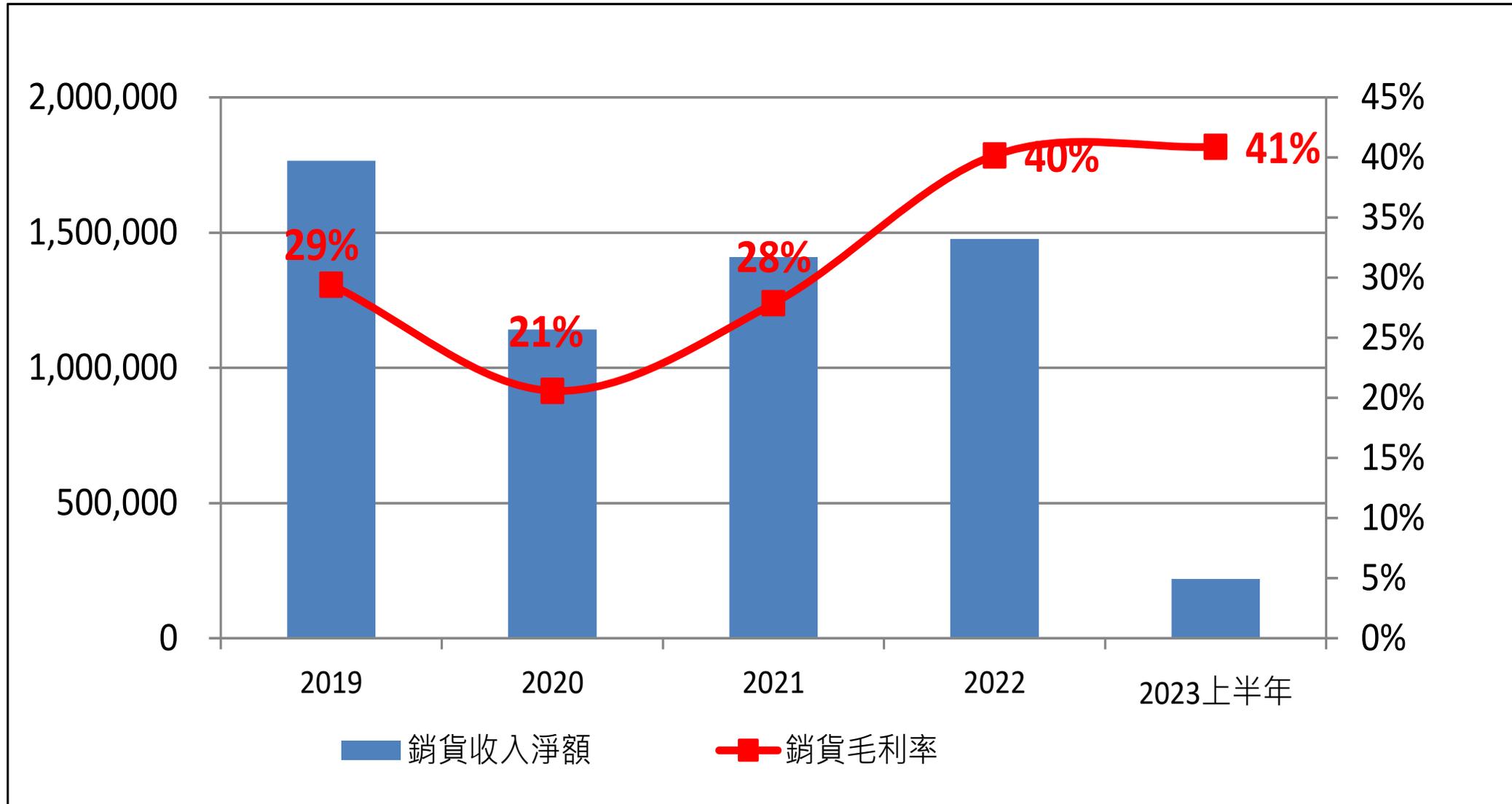
04 | 財務報告

05 | Q&A

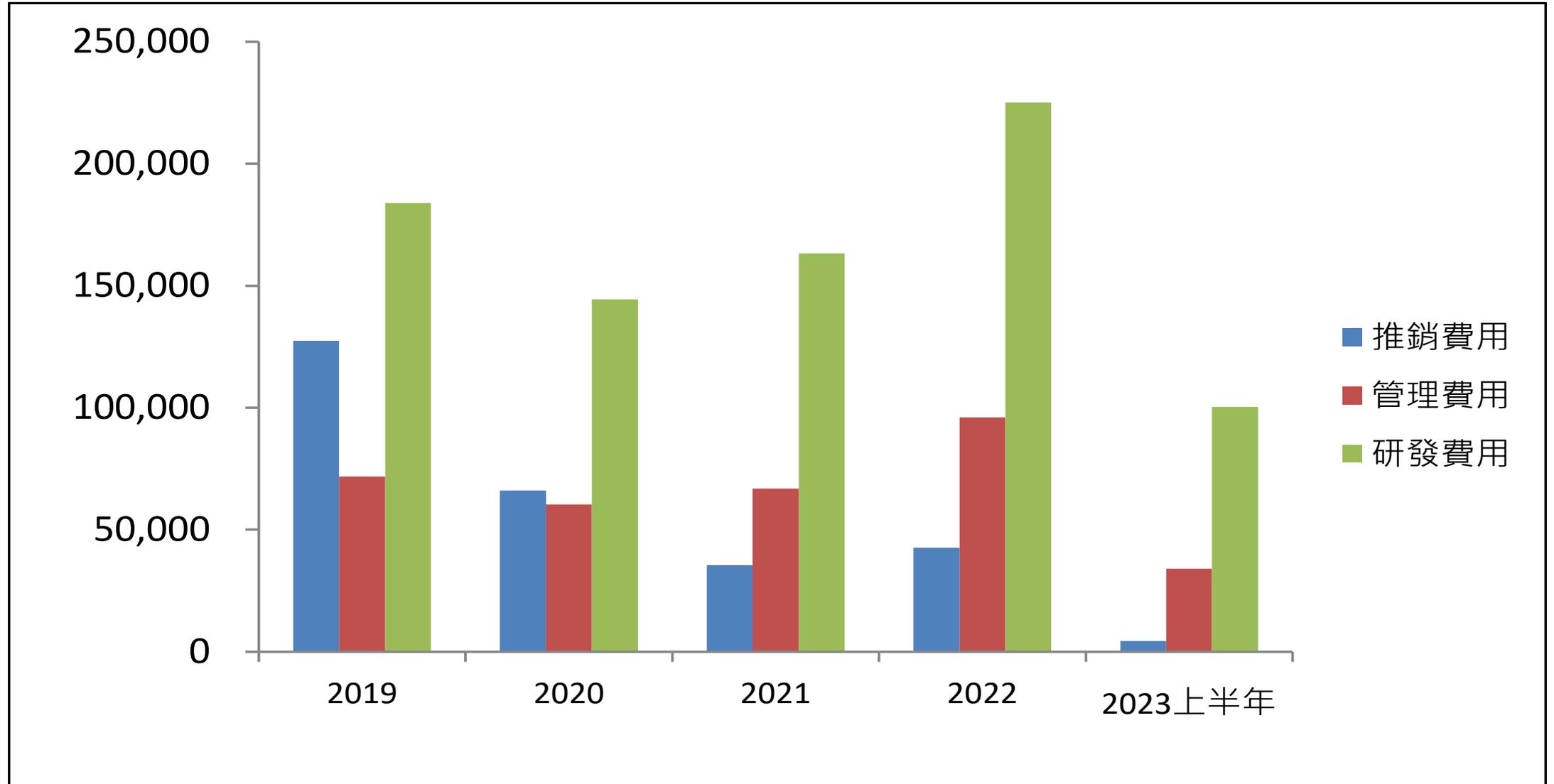
112第2季財務報告 簡明合併損益表

項目(新台幣仟元)	2023年1月1日至6月30日	百分比	成長率
營業收入	219,717	100.0%	-73.6%
營業成本	129,856	59.1%	-74.6%
營業毛利 (毛損) 淨額	89,861	40.9%	-72.1%
推銷費用	8,538	3.9%	-74.0%
管理費用	34,046	15.5%	1.7%
研究發展費用	100,294	45.6%	-11.7%
預期信用減損損失(利益)	(4,113)	-1.9%	-130.1%
營業費用合計	138,765	63.2%	-28.3%
營業利益 (損失)	(48,904)	-22.3%	-138.0%
營業外收入及支出	12,773	5.8%	-80.1%
所得稅費用 (利益)	48	0.0%	-99.8%
本期淨利 (淨損)	(36,179)	-16.5%	-121.6%
每股盈餘	(0.46)		-122.0%

112第2季財務報告 五年銷售毛利趨勢



112第2季財務報告 五年營業費用比較



112第2季財務報告 三年上半年財務比率比較

項目(新台幣仟元)	2023年 上半年	YoY	2022年 上半年	YoY	2021年 上半年	YoY
銷貨收入淨額	219,717	-74%	833,123	14%	732,620	14%
銷貨毛利率	40.9%	6%	38.7%	27%	27.0%	27%
營業費用	138,765	4%	133,707	-31%	193,660	-31%
營業費用率	63.2%	172%	23.2%	27%	18.3%	27%
營業外收入及支出	12,773	-80%	64,295	-440%	(18,930)	-440%
歸屬予母公司業主之本期淨利	(37,082)	-122%	167,917	312%	40,771	312%
純益率	-17.0%	-185%	20.0%	233%	6%	233.3%
每股盈餘(元)	-0.46	-122%	2.09	305%	0.52	305%
權益報酬率(%)	-3.1%	-119%	16.2%	251%	4.6%	251%



目錄

CONTENTS

01 | 公司簡介

02 | 市場概況

03 | 營運重點

04 | 財務報告

05 | Q&A

Q & A

